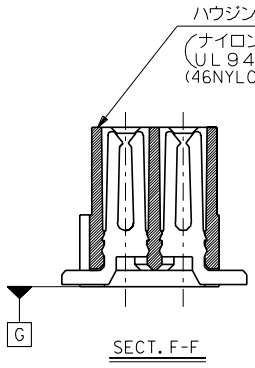
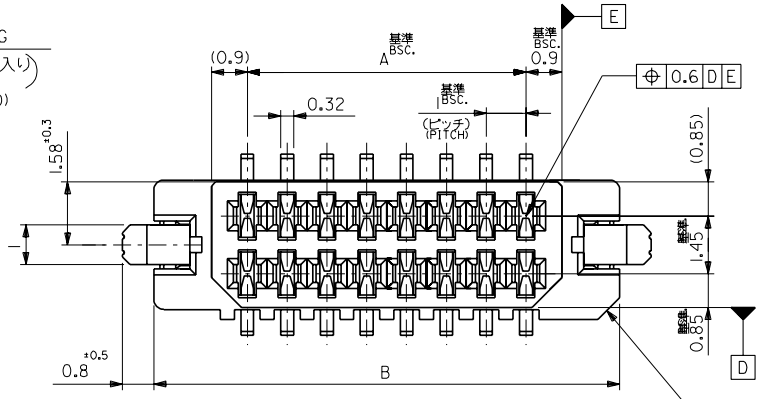
ENG. NO SD-52365-**20

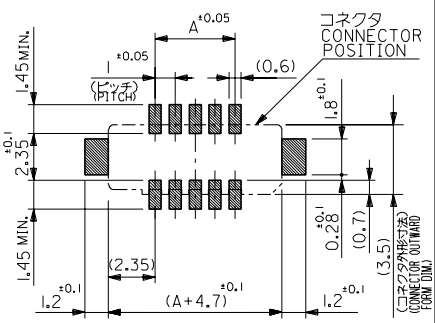
EDP NO.

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

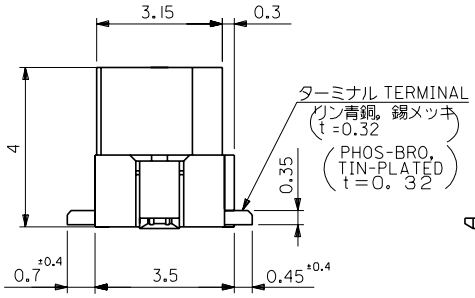


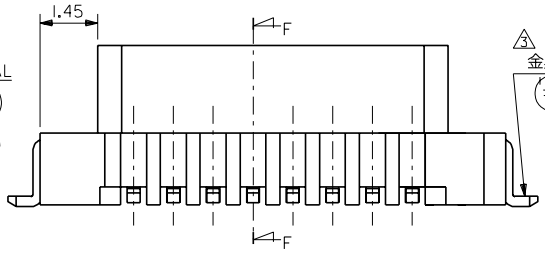


回路番号1（表示用切欠き）
CHAMFERING TO INDICATE CKT NO.1.



パターン参考寸法（マウント面）
RECOMMENDED DIM. FOR P.C.BOARD
MOUNTING PATTERN (REF.)





3 金具 FITTING NAIL
(リン青銅，錫メッキ
t =0.25
(PHOS-BRO,
TIN-PLATED
t=0.25

18.7	14	52365-3020	30
17.7	13	-2820	28
16.7	12	-2620	26
15.7	11	-2420	24
14.7	10	-2220	22
13.7	9	-2020	20
12.7	8	-1820	18
11.7	7	-1620	16
10.7	6	-1420	14
9.7	5	-1220	12
8.7	4	-1020	10
7.7	3	-0820	8
6.7	2	52365-0620	6
B	A	ENG.NO	極数 CIRCUIT

注記NOTES.

1. 嵌合相手：53268-**10 ，53268-**20
   MATES WITH：53268-**10 ，53268-**20
2. ハウジングの底面 G からの金具及びターミナル半田付面のズレ量は
   上方向0．1MAX．下方向0．15MAX．とする。
   MISALIGNMENT OF SOLDER TAIL TIP AND FITTING NAIL FROM G
   ：UPPER DIRECTION 0.1mmMAX.
   ：LOWER DIRECTION 0.15mmMAX.

3 パターンハクリ止メ用金具
FITTING NAIL FOR PREVENTION OF PEELING OF P.C.B. PATTERN.

角度 ANGLE	±3°
30以上 OVER	±0.3
10以上 OVER 30未満 UNDER	±0.25
10未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
A	変更 REVISED (J20684)	S.T.	'92/8/ 3
O	新規作成 PROPOSED (J00464)	M.O.	'90/5/8

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

材料 MATERIAL 図中参照 SEE DRAWING
仕上げ FINISH —#—
適用電線範囲 WIRE RANGE —#—
被覆外径 INS. RANGE —#—
DRAWN BY '90/5/ 8 T.HARUYAMA
CHK'D BY '92/8/ 3 S.TADOKORO
APP'D BY '92/8/ 3 M.FUKUSHIMA
尺度 SCALE —#—

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
EDP. NO.
ENG. NO. SD-52365-**20
REV A
TITLE 名称 1.0 BOARD TO BOARD CONN. REC. HSG. ASS'Y SMT.

A52365B.S02

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

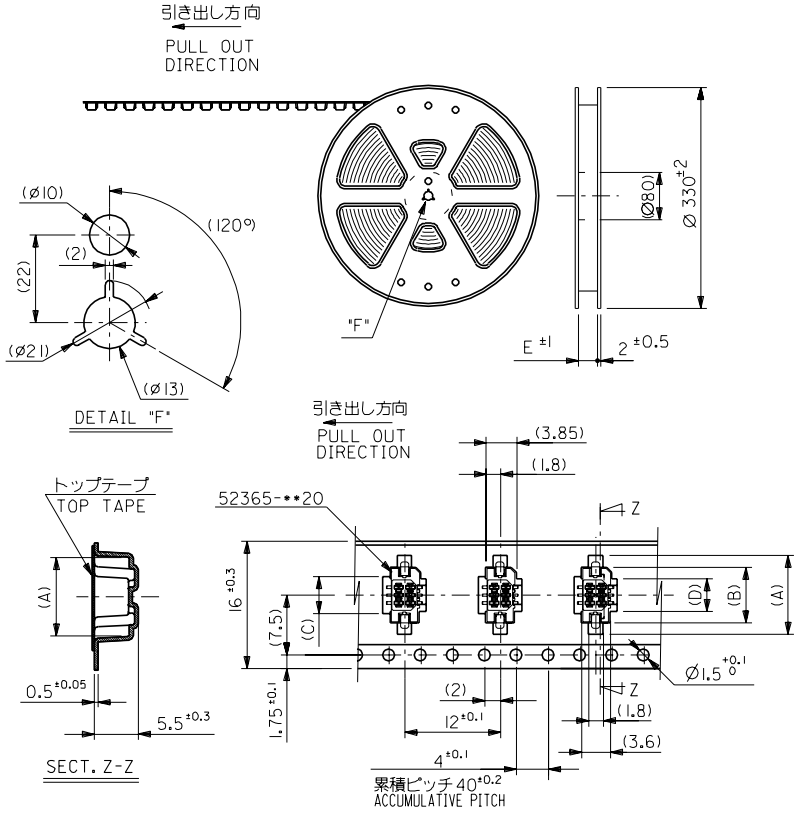
MXJ-8

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor

ENG. NO SD-52365-**91

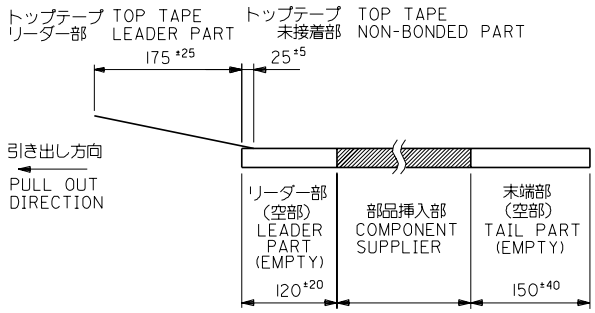
EDP NO.

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



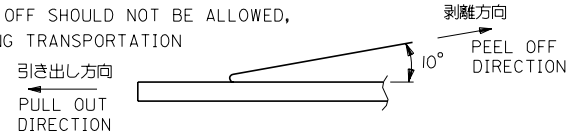
注記 NOTES

1. 梱包数量： 1000 個／リール NUMBER OF CONNECTORS: 1000PCS/REEL
2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH



3. トップテープの剥離強度：（剥離方向は下図参照）
   60gf MAX. 尚、本規格値は、出荷時に適用。
   （但し、輸送時に剥離が発生しない事。）

PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE
60gfMAX.(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,
DURING TRANSPORTATION



4. 材料 MATERIAL
   キャリアテープ：ポリプロピレン（PP） CARRIER TAPE:POLYPROPYLENE
   トップテープ：PET，PE，PEF TOP TAPE:PET,PE,PEF
   リール：ポリスチレン（PS） REEL:POLYSTYREN(PS)
   <リサイクル材を含む> <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

16	17.5	4.1	4.6	7	9.9	52365-0691	6
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	(D)	(C)	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.5
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

LTR	記号	変更内容 REVISION RECORD	DR.	CHK.	日付 DATE
D	変更 REVISED	(J2001-0479)	T.K.	T.I.	'00/12/20
C	変更 REVISED	(J30601)	S.A.	M.F.	'93/6/22
B	変更 REVISED	(J20879)	S.T.	M.F.	'92/9/28
A	変更 REVISED	(J20684)	S.H.	S.T.	'92/8/ 3
0	新規作成 PROPOSED	(J00464)	T.H.		'90/5/8

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	—//—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—//—
被覆外径 INS. RANGE	—//—
DRAWN BY '90/5/ 8 T.HARUYAMA	CHK'D BY '00/12/20 T.ITO
APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE —//—

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

EDP. NO. —//—

ENG. NO. (SHEET 1 OF 2) SD-52365-**91 REV D

TITLE 名称 1.0 B-To-B Hsg Assy Str SMT Embstp Pkg

5949909B.S02 A

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

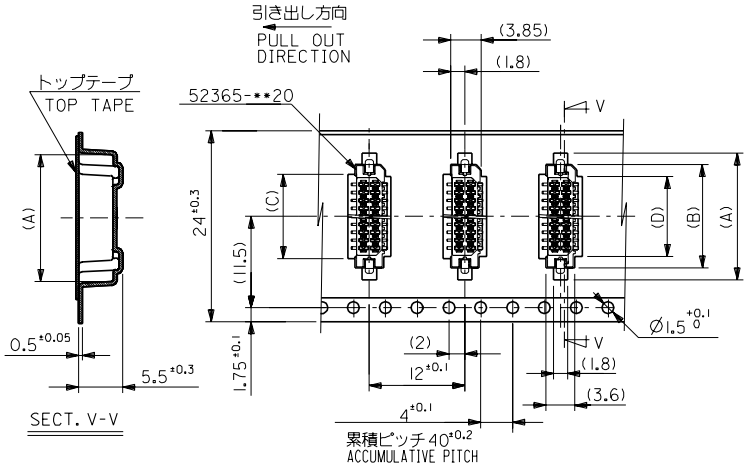
MXJ-8

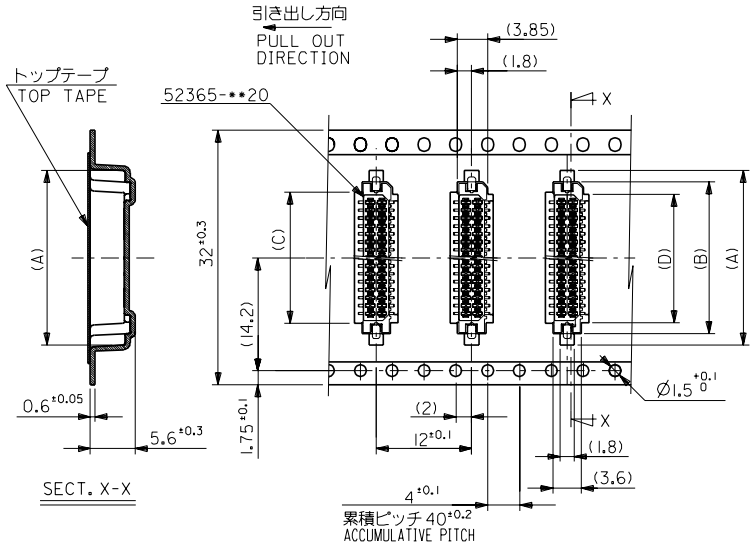
Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor

ENG. NO SD-52365-**91

EDP NO.

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING





32	33.5	16.1	16.5	19.05	21.95	52365-3091	30
		15.1	15.5	18.05	20.95	52365-2891	28
		14.1	14.5	17.05	19.95	52365-2691	26
		13.1	13.5	16.05	18.95	52365-2491	24
24	25.5	12.1	12.6	15	17.9	52365-2291	22
		11.1	11.6	14	16.9	52365-2091	20
		10.1	10.6	13	15.9	52365-1891	18
		9.1	9.6	12	14.9	52365-1691	16
		8.1	8.6	11	13.9	52365-1491	14
		7.1	7.6	10	12.9	52365-1291	12
		6.1	6.6	9	11.9	52365-1091	10
		5.1	5.6	8	10.9	52365-0891	8
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	(D)	(C)	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
D	変更 REVISED (JC2001-0479)	T.K. T.I.	'00/12/20
C	変更 REVISED (J30601)	S.A. M.F.	'93/6/22
B	変更 REVISED (J20879)	S.T. M.F.	'92/9/28
A	変更 REVISED (J20684)	S.H. C.Y.	'92/8/ 3
0	新規作成 PROPOSED (J00464)	T.H.	'90/5/8

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

材料 MATERIAL: SHEET 1 OF 2 参照 REFER TO SHEET 1 OF 2

仕上げ FINISH: //

適用電線範囲 WIRE RANGE: //

被覆外径 INS. RANGE: //

DRAWN BY '90/5/ 8 T.HARUYAMA

CHK'D BY '00/12/20 T.ITO

APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA

尺度 SCALE: //

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

EDP. NO. //

ENG. NO. (SHEET 2 OF 2) SD-52365-**91 REV D

TITLE 名称
1.0 B-TO-B Hsg Assy Str SMT Embstp Pkg

5949909B.S03 A

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

MXJ-8

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor